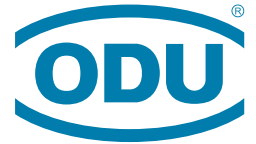


A PERFECT ALLIANCE.



ODU AMC[®] HIGH-DENSITY

Advanced Military Connector Solutions

MINIATURSTECKVERBINDER



KLEINER

SCHNELLER

LEICHTER

ODU AMC[®] High-Density ist eine Miniatursteckverbinderserie, die speziell für Anwendungen in widrigen Umgebungsbedingungen konzipiert wurde. Sie wird in einer Vielzahl von Soldatenkommunikations- und Future-Soldier-Systemen eingesetzt, bei denen erhebliche Gewichts- und Raumbeschränkungen zu beachten sind. Dazu gehören Feldfunkgeräte, tragbare Computer, Nachtsichtgeräte, mobile Entfernungsmessgeräte und Zielobjektive.

Die kompakten und leichten Steckverbinder bieten Höchstleistung bei der Datenübertragung, hohe Zuverlässigkeit und ein einfaches Handling.

Mit Gehäusedurchmessern von 10 mm bis 18,5 mm und bis zu 40 Kontakten ermöglicht die ODU AMC[®] High-Density Serie in kompaktester Bauweise verschiedene Signalkonfigurationen und maßgeschneiderte Modelle für Stromversorgung (bis zu 15 A) und Datenübertragung (USB[®] 3.1 Gen1¹ mit 5 A Strom).

¹ Diese ODU-spezifischen Steckverbinder können gängige Datenübertragungsprotokolle wie USB[®] 3.1 Gen1 übertragen, sie sind jedoch keine USB[®]-Norm-Steckverbinder.

KOMPAKTES DESIGN

Sehr hohe mechanische und elektrische Widerstandsfähigkeit und Verlässlichkeit trotz geringer Größe

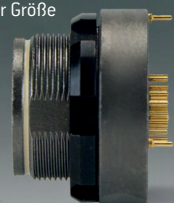


KLEINSTE ABMESSUNGEN

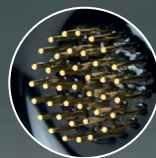
Ø von weniger als 10 mm
(Größe 00, 7 Kontakte)



7 mm

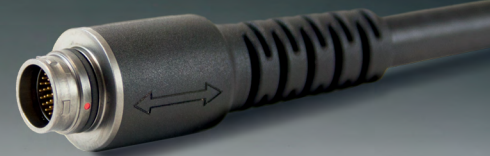
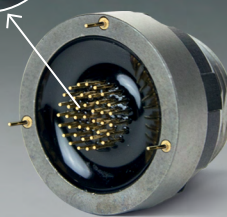


12 mm



HOHE KONTAKTDICHTE

Kontaktdichte von bis zu 40 Kontakten in einer kompakten Bauweise



SYSTEMLÖSUNG

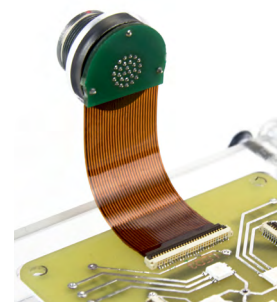
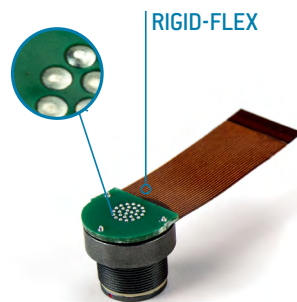
Innovative Terminierungs- und Extrusionsmöglichkeiten für Kabelzugentlastung

EIGENSCHAFTEN

- 2- bis 40-polig
- 4 Größen
- Wasserdicht IP68
- Kontakteinsätze vielseitig und individuell konfigurierbar: Signal-, Power- und Datenübertragung in einem Steckverbinder möglich
- >5.000 Steckzyklen
- Break-Away-Funktion für maximale Sicherheit
- Extrem robustes und stabiles Gehäuse mit nicht-reflektierender Oberfläche
- Betriebstemperaturbereich von -51 °C bis +125 °C
- Kontakte für Löt- und Printanschluss
- Leicht, kompakt und einfach im Handling – auch blind steckbar
- Datenübertragung mit USB® 2.0 + USB® 3.1 Gen1¹
- Mechanische und optische Farbkodierung
- Gute Korrosionsbeständigkeit
- Systemlösung

LEITERPLATTENANSCHLUSS

ODU AMC® High-Density Geräteteile können zur direkten Anbindung an die Leiterplatte oder als Starr-Flex-Lösung geliefert werden. Das Lötverfahren ist geprüft und für alle verfügbaren Einsätze geeignet.



VORTEILE

- Kleinste Abmessungen
- Kompaktes und robustes Design
- Hohe Kontaktdichte
- Hohe Schutzart zum Schutz vor Staub und Wasser, sowohl im gesteckten als auch ungestecktem Zustand
- Lange Lebensdauer
- Flexibilität durch schnelle & sichere Verbindung und Trennung sowie individuelle Konfigurationen
- 4 Kodierungsoptionen, um Fehlstecken zu verhindern
- Problemlose Datenübertragung
- Reduzierte Zusammenschaltungsverluste
- Stecker- und Kabelkonfektion, alles aus einer Hand

Bau- größe	Pol- zahl	Geeignet für	Anschlussart		Max. Kabeldurchmesser	Max. Strom- stärke ³	Prüfspannung V gem. SAE 13441	Nenn- spannung ⁴ V
			Nur Leiter- platte ² Typ GK	Löt				
00	02	Strom	•	•	2 x AWG 24	3 A	1.200	300
	04	Signal	•	•	4 x AWG 28	1 A		
	04	USB® 2.0 ¹	○	•	2 x AWG 28	1 A	750	250
			•	•	2 x AWG 24	3 A		
0	07	Signal	•	•	7 x AWG 28	1 A	750	250
	12	USB® 3.1 Gen1 ¹ + Strom	○	•	10 x AWG 28	1 A	750	250
			•	•	2 x AWG 22	5 A		
1	16	Signal	•	•	16 x AWG 28	1 A	750	250

Alle Maßangaben in mm
Die Abbildungen sind teilweise Illu-
strationen. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Wir behalten uns das
Recht vor, Produkte und deren tech-
nische Spezifikationen, soweit es dem
technischen Fortschritt dient, jeder-
zeit zu ändern. Mit Erscheinen dieser
Publikation verlieren deren Vorgänger
ihre Gültigkeit. Diese Publikation steht
auch als PDF-Datei zum Download
auf www.odu.de zur Verfügung.

ODU GmbH & Co. KG
Pregelstr.11
84453 Mühldorf a. Inn
Deutschland
Telefon: +49 8631 6156-0
Fax: +49 8631 6156-49
E-Mail: zentral@odu.de

¹ Diese ODU-spezifischen Steckverbinder können gängige Datenübertragungsprotokolle wie USB® 3.1 Gen1 übertragen, sie sind jedoch keine USB®-Norm-Steckverbinder.
² Layout auf Anfrage ³ Einzelkontaklast ⁴ Maximale Betriebsspannung zwischen Meereshöhe und 2000 m gemäß SAE 13441. Bei einigen Anwendungen sind die Sicherheitsanforderungen an die Betriebsspannung noch strenger. Dies muss bei der Geräteentwicklung berücksichtigt werden. © Auf Anfrage